

国泰海通证券股份有限公司

关于芯联集成电路制造股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：芯联集成
保荐代表人姓名：徐亦潇、周成材	被保荐公司代码：688469

重大事项提示

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）上市时未盈利，2026 年 1-6 月公司实现营业收入 45.62 亿元，同比增长约 30.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.78 亿元，较上年同期增加约 4.49 亿元，与上年同期相比增长约 263.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-0.65 亿元，同比减亏 87.84%。

截至报告期末，公司存在尚未盈利风险。当前公司正处于规模扩张阶段，需持续稳定保持相当的技术投入与资本投入，产品结构在持续优化中，公司将通过持续优化产品结构、增强技术竞争力，稳步提升盈利能力；同时着力强化技术研发与生产管理效能，稳步提升市场渗透率、完善合作伙伴生态、增强技术团队实力，为公司盈利能力的持续改善奠定基础。

经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]548 号）批复，公司首次公开发行 A 股 194,580.00 万股（超额配售选择权全额行使），每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.69 元，募集资金总额为人民币 1,107,160.20 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,078,341.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 5 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。

在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2026 年半年度持续督导情况报告如下：

一、2026 年半年度保荐机构持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。

项目	工作内容
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司不存在控股股东、实际控制人；上市公司相关主体不存在未履行承诺的情况；上市公司已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个工作日内披露现场核查报告。	本持续督导期间，上市公司不存在控股股东、实际控制人，上市公司及相关主体未出现该等事项。
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项目	工作内容
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；（二）资产被查封、扣押或冻结；（三）未能清偿到期债务；（四）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，保荐机构已按照要求针对 2026 年日常关联交易预计发表核查意见；上市公司及相关主体未出现其他事项
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；（二）核心技术人员离职；（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；（四）主要产品研发失败；（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）所持上市公司股份被司法冻结；（二）质押上市公司股份比例超过所持股份 80%或者被强制平仓的；（三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司不存在控股股东、实际控制人。
15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议。

项目	工作内容
17、保荐机构发表核查意见情况。	2026 年 1-6 月，保荐机构发表核查意见具体情况如下：2026 年 4 月 21 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的核查意见》；2026 年 4 月 21 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的核查意见》；2026 年 4 月 21 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司核心技术人员调整的核查意见》；2026 年 4 月 21 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告》；2026 年 4 月 21 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》；2026 年 4 月 29 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》；2026 年 5 月 12 日保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年度持续督导年度跟踪报告》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐机构开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

（一）尚未盈利的风险

当前公司正处于规模扩张阶段，需持续稳定保持相当的技术投入与资本投入，产品结构在持续优化中，故公司扣除非经常性损益的净利润仍为负值。公司将通过持续优化产品结构、增强技术竞争力，稳步提升盈利能力；同时着力强化技术

研发与生产管理效能，稳步提升市场渗透率、完善合作伙伴生态、增强技术团队实力，为公司盈利能力的持续改善奠定基础。

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

随着下游市场需求的持续增长以及公司产能的稳步扩张，公司产品产量与销量均呈现逐年上升的良好态势。然而，如公司在后续经营过程中遭遇宏观经济环境恶化、行业周期性波动导致下游需求萎缩，或因客户验证及客户开发进度未达预期，则公司未来经营收入存在下滑的可能性。

（三）核心竞争力风险

1、技术及产品迭代风险

半导体行业技术和产品更新迭代较快，公司的持续发展源于对客户需求变化的敏锐洞察与快速响应，以及产品适配性与成本竞争力。受半导体行业固有特性影响，公司仍会面临产品迭代加速、研发周期漫长、资金投入密集等多重挑战。若公司技术与工艺水平未能跟上行业领先步伐，新技术、新工艺的研发升级受阻，或下游客户需求出现难以预见的重大变化，则可能导致公司产品被竞争对手赶超或替代，削弱公司在新产品领域的市场领先地位。

为保障产品契合市场需求并紧跟行业演进趋势，公司在研发领域持续投入大量资金与人力资源。公司坚持“平台化+特色化”双轨并行的技术路线，着力打造覆盖多品类的工艺平台，积极跟踪前沿应用需求；重视产品在工艺开发、量产验证等过程中数据的系统性积累与价值挖掘，构建覆盖工艺全生命周期的技术资产体系；建立客户联合研发机制，快速感知市场需求的变化，在技术共创中形成深度信任，增强客户合作的黏性和韧性。

2、关键技术人员流失风险

技术人员是公司生存和发展的关键，也是公司获得持续竞争优势的基础。随着公司规模扩张，对专业技术人才的需求与日俱增，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍存在关键技术人员流失的风险。

在人才激励方面，公司提供有竞争力的薪酬及股权激励，打通技术与管理双晋升通道；提升研发与创新环境，完善职业发展规划与福利体系，增强归属感与忠诚度。

3、知识产权风险

公司所处的行业属于技术密集型、人才密集型行业，产品在研发、生产制造过程中涉及专利、非专利技术等知识产权数量众多。通过高研发投入和不断的技术积累，公司已拥有多项自主知识产权，同时也累积工艺参数、验证数据等商业秘密。公司的专有技术、商业秘密、专利等存在被他人盗用或不当使用的可能。此外，现有知识产权存在被监管机构宣告无效或撤销的风险，亦不排除公司与竞争对手之间发生其他知识产权纠纷。

公司坚持知识产权管理体系和战略与公司发展战略相互匹配，充分做好知识产权的认定和保护，有效保护商业秘密，避免出现专利纠纷等情况。

（四）经营风险

1、行业周期风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力。如果由于国际关系等因素引致下游市场整体波动，亦或由于中国半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

面对技术迭代加速与市场需求多元化的行业格局，公司始终保持战略定力与前瞻视野。一方面，在现有四大领域内深耕细作，通过持续加大研发投入、优化产品性能、缩短迭代周期来巩固竞争优势；另一方面，密切跟踪新兴应用场景的萌芽与成长，提前进行技术储备与产品预研。以市场需求为牵引、以技术创新为驱动，为行业周期的轮动做好充足的准备，同时也为行业发展注入动能。

2、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司资产规模、业务规模及员工数量的快速增长，各项业务进一步扩张，组织架构与经营管理的复杂程度显著提升，对管理能力提出更高要求。若公司未能及时、有效地应对规模扩张带来的管理挑战，可能引发管理风险。

公司高度重视组织管理，不断优化组织架构，明确权责边界，引入 AI 智能管理工具，实现流程标准化与信息透明，提升决策效率与协同能力。

（五）财务风险

1、信用风险

随着公司业务规模持续扩张，交易对手方数量显著增加，若未来部分客户或供应商的经营状况出现不利变化，公司可能面临应收账款回收延迟或采购交付违约等信用风险。

公司建立了严格的评估/准入机制，对交易第三方开展审慎评估，与信誉优良的第三方开展业务合作。公司主要客户及供应商均为国内外行业头部企业，资本实力雄厚、资信水平较高，能够有效降低信用风险敞口。

2、汇率波动风险

人民币汇率受国际收支、外汇储备、利率水平及通货膨胀等多重因素影响，对美元及其他主要货币的汇率呈现波动特征。公司销售、采购等业务环节均涉及外币计价交易。鉴于市场走势及外汇政策等因素对汇率的影响难以准确预判，人民币汇率的波动可能对公司的流动性状况及现金流产生不利影响。

公司从制度建设、金融工具运用、业务操作优化三个层面构建了系统化的防范体系。在制度建设方面，公司建立汇率风险管理机制，制定外汇套期保值管理制度，确保所有交易以正常生产经营为基础、以规避风险为目的；在工具运用方面，公司适时采用远期结售汇等方式，减少或消除汇率带来的不确定性；在业务操作策略方面，优先选择有利的计价货币进行业务结算。

（六）行业风险

近年来，受益于国内半导体市场需求的持续扩大，行业整体呈现快速扩张态势。然而，由于国内半导体产业发展历程相对较短，市场供需仍处于动态平衡之

中，行业生态体系尚需持续完善。当前，半导体产业已被列为国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，享有强有力的政策支持。但需关注的是，若未来相关主管部门出台的法律法规、行业标准、产业政策、出口政策等对公司产品及业务产生限制，则可能对公司的盈利能力及可持续发展造成不利影响。

在公司发展经营中，将密切跟踪政策动态，建立合规预警机制；同时多元化布局供应链，降低单一政策依赖；加强自主研发，提升技术自主可控能力。

（七）宏观环境风险

全球宏观经济波动、行业景气度变化及国际关系等因素，共同赋予了半导体行业显著的周期性特征。由于半导体行业高度依赖下游及终端应用市场的需求波动，若未来宏观经济持续走弱，终端应用市场（尤其是增量需求）出现萎缩，客户将相应减少采购规模，行业整体面临一定的波动风险。

在战略层面，公司通过多元化布局市场与产品、前瞻性建立技术护城河、建设韧性的供应链，构建抵御宏观环境风险的韧性；在执行层面，通过产能弹性配置、订单柔性管理等方式精细化运营来管控风险。

四、重大违规事项

2026 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	456,221.94	349,519.78	30.53
利润总额	4,136.02	-93,672.85	104.42
归属于上市公司股东的净利润	27,833.34	-17,034.04	263.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,512.96	-53,560.81	减亏 87.84%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	202,947.38	110,148.22	84.25
经营活动产生的现金流量净额	126,908.57	98,142.51	29.31

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,335,195.30	1,303,436.21	2.44
总资产	3,468,617.08	3,318,098.63	4.54

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
毛利率（%）	12.71	3.54	增加 9.17 个百分点
净利率（%）	0.91	-26.80	增加 27.71 个百分点
息税折旧摊销前利润率（%）	44.48	31.51	增加 12.97 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	-0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	-0.01	-0.08	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.11	-1.38	增加 3.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-0.49	-4.34	增加 3.85 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	19.84	27.59	减少 7.75 个百分点

注：本期研发投入为本期费用化的研发费用与本期资本化的开发支出之和。

（三）公司主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入变动的主要原因：

（1）公司实现营业收入 45.62 亿元，同比增长 30.53%。伴随半导体行业需求快速增长，公司积极开拓新客户、新领域，实现客户结构的多元化与均衡化；同时不断丰富与客户合作的产品矩阵，从单一品类向多品类、多应用场景延伸，进一步巩固和提升客户粘性。

（2）公司四大应用领域构筑公司发展基石，核心业务营收快速增长。①AI 业务营收同比增长 84.31%，在 AI 基建和光互连领域，公司布局了完整的技术平台和产品矩阵；在 AI 终端方面，构筑了从环境感知到供电保障的完整链路能力；②车载业务作为公司核心业务基本盘，依托市场和技术的先发优势，业务规模持续做大，收入同比增长 3.53%。公司产品覆盖主驱、OBC（车载充电机）、底盘、车身、热管理等，覆盖国内九成以上新能源车企。③高端消费电子营收同比增长

31.76%，公司产品已覆盖 MEMS 麦克风、激光雷达驱动芯片 VCSEL 光源、IMU 运动传感芯片等，从环境感知到稳定供电，相关产品已嵌入多种 AI 终端设备；④工控业务营收同比增长 21.29%，光伏、储能混碳功率模块、工商业储能模块已批量交付。

2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、息税折旧摊销前利润（EBITDA）变动的主要原因：

（1）报告期内公司持续推进产品结构优化升级，加大高附加值、高技术含量产品的研发与市场拓展；成熟产线产能利用率保持高位，产能充分释放；有效落实供应链管控与精益生产管理等降本增效措施。上半年公司晶圆产量 148 万片（折合 8 英寸），同比增长 28.86%，规模效应快速显现，折旧摊销占营业收入比重下降至 41.13%，同比下降 13.84 个百分点，公司产品整体盈利能力显著提升。

（2）公司积极布局“AI in All”策略，将人工智能作为驱动业务增长与组织进化的核心引擎，提升管理和组织协同效能。上半年公司期间费用率 6.01%，同比下降 0.78 个百分点。

（3）前期技术投入成果开始显现。公司确立了 MEMS、功率、模拟 IC、MCU、光互连五大主要技术方向，持续开展工艺与技术研发，不断丰富专利及非专利技术储备。为了保障 12 英寸数模混合芯片产线建设项目的快速落地，公司向芯联先进授权了相关专利及非专利型专有技术。根据相关《企业会计准则》，上半年公司就授权业务确认收入 2.79 亿元，贡献归母净利润 2.56 亿元。

3、毛利率变化的主要原因

2026 年上半年，公司毛利率同比大幅提升 9.17 个百分点，主要得益于公司核心产品市场需求持续旺盛、产能利用率稳步提升以及新客户、新订单的持续落地，公司前期在产能建设、产品布局等方面的投入正逐步转化为经营成果，规模化效应开始集中显现。2026 年上半年公司毛利率达到 12.71%，较上年同期提升 9.17 个百分点。公司毛利率的显著改善主要源于以下几个方面的协同驱动：一是产品结构持续优化，高附加值产品占比逐步提高；二是生产运营效率提升，精益管理和精益生产效能显现；三是产能利用率提升带来的单位固定成本摊薄效应。

公司已从“规模建设”进入“利润释放”的良性通道，盈利能力仍将继续提升。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发团队深耕前沿技术，技术实力领先

公司坚持“市场+技术”双轮驱动的发展战略，在 AI 数据中心、人工智能、新能源等重点发展的战略性新兴产业领域开展前瞻性技术布局，结合自身在特色工艺领域的深厚积累，不断拓展技术边界，持续巩固并强化行业领先的技术研发优势，为未来业务增长注入源源不断的创新动能。公司研发团队汇聚了 1,238 名技术实力深厚、经验丰富的技术精英。在丰富的研发项目和完善的研发体系下，公司研发团队不仅具备前瞻性的技术视野，同时不断提升对现有技术体系的深刻理解和掌控。

2026 年上半年公司研发投入 9.05 亿元，继续保持高水平的研发投入。报告期内，公司新增获得发明专利等 74 项，累计已获得发明专利等知识产权 648 项，构成了公司核心竞争力的重要壁垒。

（二）构建多层级的供应链韧性体系，供应链稳固且自主可控

公司构建并实施了符合车规级标准的供应商管理准入体系，建立了完善的供应商绩效评估机制，实现了对供应商的全生命周期管理。在质量改进、市场份额分配、升降级制度等关键环节，形成了系统化、规范化的管理体系，确保供应链的稳定性和可靠性。

在关键业务领域，公司已与国内外主流供应商建立了紧密的战略合作关系，共同应对市场变化和策略调整，为公司的长期稳健发展提供了有力支撑。通过持续推进直接材料和关键零部件的多元化项目，公司已实现国内领先的多元化供应链布局。此外，通过与核心战略供应商的深度协作，公司获得了高优先级的服务支持和具有成本竞争力的长期合作方案，为持续发展奠定了坚实基础。

（三）扎实推进“AI in All”举措，交付质量与生产力双提升

公司将人工智能作为驱动业务增长与组织进化的核心引擎，以“高价值、能落地”为宗旨，在广度和深度两个维度上稳步推进“AI in all”系统工程。

通过长期的研发、推广和培训，AI 应用在公司已经深入人心，多个领先的部门已经实现了交付质量和生产力的显著提升。随着持续的前沿应用探索、最佳实践推广和全员培训，公司整体的交付质量和生产力提升也将按计划达成，实现“可感”的实际收益。同时，以 AI Agent 来解决真实复杂业务场景的多个先导项目进入了深水区，针对 AI 原生应用的“再数字化”项目在高强度推进，预计将陆续实现关键里程碑交付。

（四）拥有完整的车规级研发量产平台和全流程车规级质量管理体系

公司是国内少数具备车规级功率芯片及模组、数模混合高压模拟芯片和系统生产设计制造能力的企业，拥有种类完整、技术先进的车规级功率器件和功率 IC 研发及量产平台，是国内重要的车规、高端工业控制等核心芯片及模组制造基地。

公司坚持快速增量与质量交付并重，建成高效的数字化车规级智慧工厂，引入 AI 等智能数据分析预警与辅助缺陷判断等先进质量管控工具，持续提升质量管理水平与运营效率，并纵深推广全流程质量管理与全过程质量持续改进。公司 IPD（集成产品开发）变革项目已实现规模化推广，建立了从研发到大规模量产的全流程车规级质量管理体系，确保研发与设计阶段质量前置管控。

公司已顺利通过 ISO9001（质量管理体系）、IATF16949（汽车质量管理体系）、ISO26262（道路车辆功能安全体系）等国际质量管理体系认证，得到莱茵颁发的卓越质量体系管理奖，以及诸多客户质量嘉奖，如获得公司全球排名前列的半导体设计公司客户颁发的“最佳质量支持”、国内头部车企颁发的“合作伙伴卓越质量奖”等。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	71,974.96	96,424.08	-25.36
资本化研发投入	18,517.09	不适用	不适用
研发投入合计	90,492.05	96,424.08	-6.15

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
研发投入总额占营业收入比例（%）	19.84	27.59	减少 7.75 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	20.46	0	增加 20.46 个百分点

公司坚持“市场+技术”双轮驱动的发展战略，在 AI 数据中心、人工智能、新能源等重点发展的战略性新兴产业领域开展前瞻性技术布局，结合自身在特色工艺领域的深厚积累，不断拓展技术边界，持续巩固并强化行业领先的技术研发优势，为未来业务增长注入源源不断的创新动能。公司研发团队汇聚了 1,238 名技术实力深厚、经验丰富的技术精英。在丰富的研发项目和完善的研发体系下，公司研发团队不仅具备前瞻性的技术视野，同时不断提升对现有技术体系的深刻理解和掌控。

公司确立了 MEMS、功率、模拟 IC、MCU、光互连五大主要技术方向，围绕新能源汽车、AI、工控、高端消费等领域的产品需求持续开展先进工艺与技术研发。公司产品方向主要包括依托 MEMS 技术开发的传感信号链芯片，以 SiC MOSFET、GaN HEMT 为主的功率器件和模组，采用 BCD 技术研制的模拟 IC，以 MCU/DSP 为主的数模混合芯片，以 VCSEL、SiPh、EML 为主的光互连芯片，以及相关的模组封装产品等。公司坚持走核心技术自主研发的道路，以追求极致产品性能为目标。

2026 年上半年公司研发投入 9.05 亿元，继续保持高水平的研发投入。报告期内，公司新增获得发明专利等 74 项，累计已获得发明专利等知识产权 648 项，构成了公司核心竞争力的重要壁垒。

（二）在研项目

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	BCD 工艺技术研发	1.SOI BCD 高压平台客户产品验证完成 2.发布 90 纳米车规 BCD 高性能平台，客户产品验证中 3.发布 55 纳米信号链平台，满足车规高可靠要求 4.新一代 55 纳米 BCD 平台开发中	1.SOI BCD 高压平台，满足新能源汽车和储能电池管理及光通信高压高精度高集成光路控制芯片需求 2.90 纳米车规 BCD 高性能平台开发完成，满足智能车载音频、大电流电源管理等应用需求 3.55 纳米信号链平台，满足车规可靠性要求，弥补国内技术平台空白	国际领先	1.SOI BCD 平台，应用于汽车 BMS AFE 和光通信高压高精度高集成光路控制芯片 2.90 纳米车规 BCD 高性能平台，应用于智能车载音频、大电流电源管理等应用需求 3.55 纳米信号链平台，应用于车规接口、端侧 AI 接口需求

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
		5.高性能电阻工艺研发完成，客户验证完成量产中	4.新一代 55 纳米 BCD 平台满足服务器电源高频化需求 5.高性能电阻工艺满足光通信运算放大芯片高精度精密需求		4.新一代 55 纳米 BCD 平台应用于高频服务器电源 5.高性能电阻工艺应用于光通信运算放大芯片
2	功率 GaN 技术研发	进一步迭代氮化镓到 G2.0, 进一步提升效率，大幅提高可靠性	产品覆盖中高低压，规格全面，性能达到国际领先	国际领先	应用于 AI 服务器电源，消费电子
3	2.0代 SiC 平面 MOSFET 研发	第二代 SiC MOS 晶圆正常发布，产品量产并上车	主要性能和可靠性达到国际领先水平，导入到多家汽车终端客户	国际领先	应用于工控、AI 服务器电源、乘用车的高可靠性、高性能 SiC MOSFET 芯片
4	塑封车载模块技术研发	第三代单面散热塑封模块实现首家客户量产	单面塑封车载模块实现量产，满足客户高性能高可靠性的需求，导入到多家客户	国际领先	产品应用于新能源汽车电控
5	灌封车载模块技术研发	新一代紧凑型高性能灌封模块完成首家量产，产品覆盖 70KW 到 200KW 主流功率段	单面塑封车载模块实现量产，满足客户高性能高可靠性的需求，导入到多家客户	国际领先	产品应用于新能源汽车电控
6	灌封工业光伏模块技术研发	进一步完善通用性工业用灌封模块产品，同时，新开发针对组串光伏 465KW 的高效 HF5 等模块，针对集中式 MW 光伏的改良版 HB3 等模块	引领光储功率模块趋势，助力 SST，SSCB 等新应用发展	国际领先	光伏逆变器，储能变流器，风电变流器，SST 固态变压器，SSCB 固态断路器
7	MCU 平台技术研发	1.90 纳米 BCD60V/120V 嵌入式闪存工艺平台客户产品导入验证中，90 纳米第二代 BCD60V/120V 嵌入式闪存工艺平台启动开发 2.55 纳米嵌入式闪存工艺平台客户产品验证完成，进入量产 3.40 纳米嵌入式闪存平台开发中	1.集成高可靠性嵌入式闪存工艺，满足新能源汽车最新 48V 系统需求。第二代平台进一步优化面积，大幅提高平台竞争力。2.55 纳米及 40 纳米嵌入式闪存工艺满足车规高可靠性及成本要求	国内领先	1.广泛应用于车载小电机驱动，车灯以及车身节点控制、超声波雷达等 2.应用于车规 MCU，工业 MCU 和安全芯片
8	8 寸 SiC MOS 项目技术研发	8 寸 SiC MOS 项目客户验证完成并量产	8 寸 SiC MOS 项目完成更多客户导入，应用从汽车扩展到工业，家电，新能源等多个领域	国内领先	应用于工控、AI 服务器电源、乘用车的高可靠性、高性能 SiC MOSFET 芯片
9	12 寸硅光 SiPh 与 SiGe HBT 器件平台技术研发	90nm 硅光、锗硅工艺平台启动研发	硅光、锗硅工艺平台满足 800G、1.6T 及以上光模块光电探测芯片及驱动放大器需求	国内领先	应用于光通信、毫米波雷达等领域
10	消费类 IMU 惯性器件研发	消费级 IMU 大规模量产	面向消费类应用，填补国内空白	国内领先	应用于手机，可穿戴等产品
11	MEMS mirror 光学	样品验证完成，进入小批量试制	研发 AI 数据中心用交换芯片，填补国内空白	国内领先	应用于 AI 数据中心交换芯片

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	传感器工艺平台开发				
12	高质量语音识别和音频捕获麦克风技术研发	样品验证完成，进入小批量试制	研发超高性能 MEMS 麦克风芯片，填补国内空白	国内领先	应用于手机、可穿戴、智能语音交互等产品
13	新一代沟槽型场截止 IGBT 技术开发	车载应用第三代沟槽型场截止 IGBT 技术完成开发，650V~3300V 产品全面布局	完成客户端产品导入，大规模量产，器件性能达到国际领先水平	国际领先	产品应用于新能源汽车电控/车载充电机/车载空压机等
14	车规级惯性 IMU 器件研发	可靠性验证完成，进入量产	研发高性能车载惯性传感器芯片，填补国内空白	国内领先	应用于车载导航，无人机等产品

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

单位：万元 币种：人民币

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）（6）=（4）/（1）	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）（7）=（5）/（3）	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=（8）/（1）	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023 年 6 月 9 日	1,107,160.20	1,078,341.70	1,250,000.00	0	1,049,268.42	0	97.30	0	24,261.57	2.25	500,000.00
合计	/	1,107,160.20	1,078,341.70	1,250,000.00	0	1,049,268.42	0	/	/	24,261.57	/	500,000.00

公司 2026 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司无控股股东和实际控制人，公司董事和高级管理人员均不存在直接持有股份的情形，其所持有公司股份亦不存在质押、冻结或减持情况。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

保荐机构督促上市公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范资金和债务风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐机构提请投资者特别关注公司所处宏观环境风险。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、半年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

徐亦潇

周成材

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日